

# DPAK (TO-252)

DPAK 符合 JEDEC 的中功率分立器件标准。

## 应用

DPAK 适用于中功率应用 (参考值为 80W\*/60A)，且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。特别适用于：

- ▶ 电机驱动器
- ▶ 电源电路
- ▶ DC-DC 转换器
- ▶ 消费类产品
- ▶ 汽车应用产品

\*壳温 = 25°C，结温 = 最高 150°C

## 可靠性认证

J-Devices 的封装采用封装组装采用成熟可靠的半导体材料。

- ▶ 全部可靠性测试包括：JEDEC 标准预处理，高温储存除外
- ▶ 85°C/85% 相对湿度，168 个小时，IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ 高压炉测试：121°C/100% 相对湿度/2 个标准大气压，96 个小时
- ▶ 温度循环：-65°C/+150°C，300 次循环
- ▶ 高温储存：150°C，1000 个小时

## 测试服务

J-Devices 为全部电源分立器件提供完全一站式的服务，我们有能力测试各种类型的电源器件，包括 MOSFET、智能电源器件，等等。

- ▶ 分立电源测试能力：
  - ▷ 直流
  - ▷ 电容 \*1
  - ▷ Rg \*1
  - ▷ 雪崩耐量测试
  - ▷ 热阻
- ▶ 程序转换
- ▶ 电气故障分析
- ▶ 集成测试、打标、外观检查和卷带式包装服务

\*1 仅抽样试验

## 特色

- ▶ 采用粗铝焊线，以实现低导通电阻与高电流密度
- ▶ 从晶圆测试到成品测试与包装的一站式服务
- ▶ 无铅电镀

## 正在开发

- ▶ 晶粒贴装采用保护环境的无铅焊膏
- ▶ 无卤素模塑化合物

## 工艺亮点

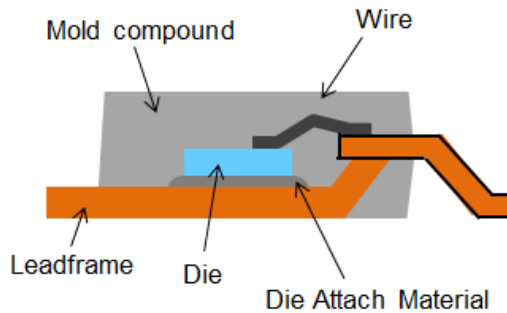
- ▶ 互连：粗铝线焊接技术
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 打标：激光打标

# DPAK (TO-252)

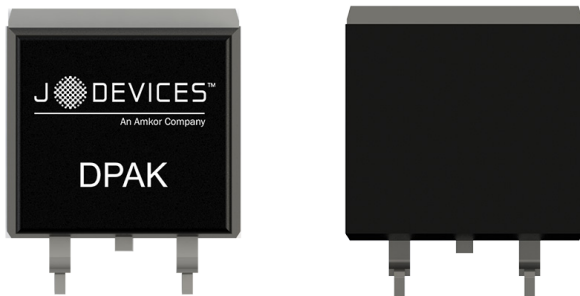
## 标准材料

- ▶ 引脚框架：铜，焊线区采用镍镀层
- ▶ 晶粒贴装：含铅焊膏
- ▶ 互连：铝线 11.8 mil (最大)
- ▶ 模塑化合物：有卤素

## 横截面



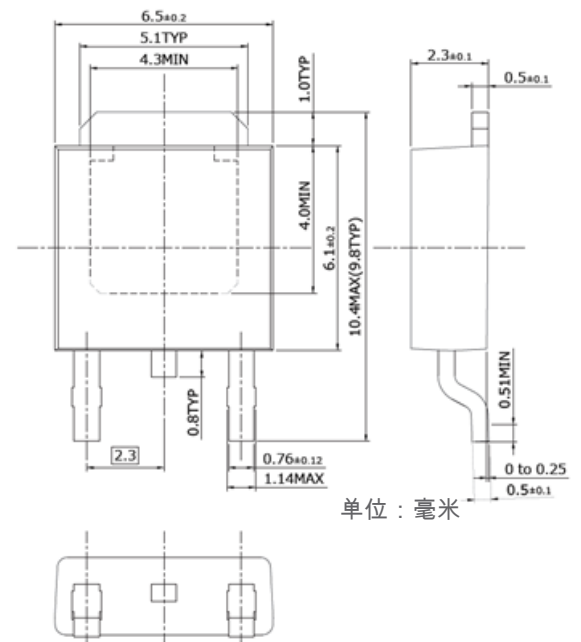
## 俯视与仰视图



## 装运

- ▶ 卷带式包装
  - ▷ 每卷 2000 片
  - ▷ 卷带宽度 10.7 毫米
  - ▷ 每卷直径 = 330 毫米
- ▶ 条形码封装标签

## 封装外形图



访问 [amkor.com](http://amkor.com) 或发送电子邮件至 [sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) 以获得更多信息。



关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2018, Amkor Technology Incorporated. 保留所有权利。DSJD414B 修改日期：10/18

